

特殊ウレタンゲルで半導体チップやウェハーなどの精密部品を守るキャリア

# Gel Base (ゲルベース)

細かな半導体やチップなどを搬送する際、細かい為数量の管理や梱包にお困りではないでしょうか？

Gel Base がそのような問題を解決します。

高い密着度とクリーン性を兼ね備えた特殊ウレタンゲルが、細かな部品をしっかりとキャッチします。

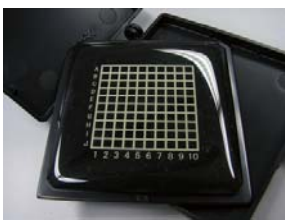
小部品の固定、搬送、検査の実施など、半導体や精密機器の最終製品を取り扱う現場に画期的な搬送方法を提案します。

## 特徴

- 1) 半導体チップ、ウェハー、MEMS、レンズ電子部品などゲル粘着によって保持するので**部品の形を選ばずに使用可能です。**
- 2) ケースとゲルに導電性を持たせているので、**静電気から部品を守ります。**
- 3) ゲルの**保持力は部品表面の粗さに応じて**お選びいただけます。
- 4) ウレタンゲルの使用によりシリコンで起こり得る**シロキサンによる部品汚染がありません。**また、粘着材による汚染もありません。



ゲルベース 50



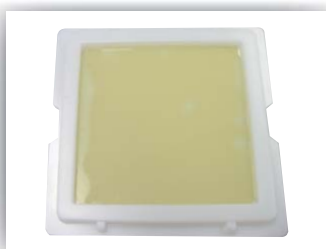
静電気対策を施したABSケースにウレタンゲルを流し込んだプレートを実装。

ケースは簡単に開閉可能。マス目の記入があるので、サイズに合わせて素子を



重さ約10gのアルミプレートも、簡単にくっつきます。

オイルなどの流出がないので、密着させる素子への汚れ付着の心配が軽減されます。

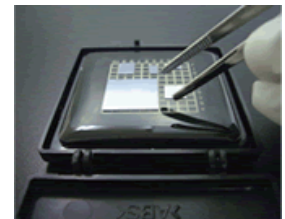
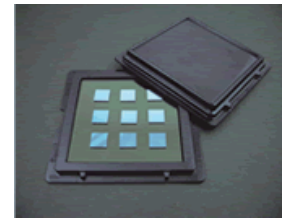


ケース本体に直接ゲルを流し込み、BGAチップのサイズを製作することも可能です。

またフラットにした汎用タイプ、凹凸をつけたタイプ、カスタム形状に成形したタイプなども製作可能です。

## 製品仕様

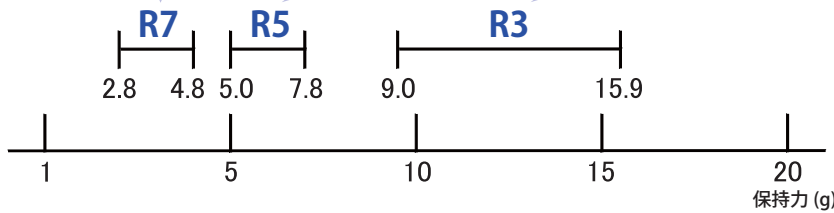
	保持力 (gf/20mm)	表面抵抗値(ゲル)	ケース体積抵抗値
R3 (強)	9.7	$4.4 \times 10^8$	$10^6 \Omega$
R5 (中)	5.6	$5.8 \times 10^8$	
R7 (弱)	3.1	$7.1 \times 10^8$	



**弱**  
磨かれたツルツルな表面の部品に適します。

**中**  
エッチングされた表面の部品に適します。

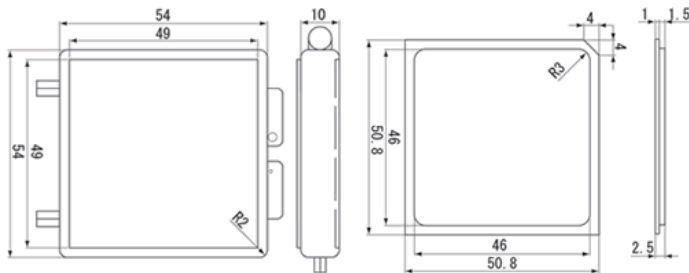
**強**  
セラミックなど少し粗い表面の部品にも使えます。



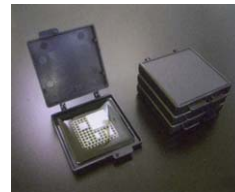
※この測定値は参考値であり、保証値ではありません。

## 製品紹介

### ■ ゲルベース 50

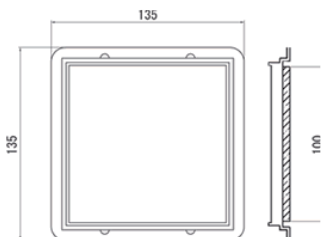


ケース本体の底に直接ゲルを塗布し、小型チップ、モジュール、デバイスなどの搬送や保管を行います



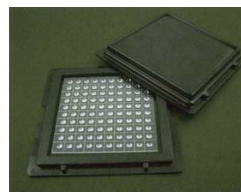
ケース、トレイ：ABS（導電性  $10^6 \Omega$ ）  
ゲル：ウレタンゲル（導電性  $10^8 \Omega$ ）

### ■ 100P タイプ



### ■ カスタマイズ ゲルベース

お客様のご要望によってゲルの形状を変えられます。



お問い合わせ：

太陽金網株式会社 東京営業所 開発部  
〒141-0032 東京都品川区大崎3-6-9  
PHONE：03-3493-7864 FAX：03-3493-7113

**TWC** 太陽金網株式会社  
<http://www.twc-net.co.jp>